

ハイエンドGPU×2、第9世代 インテル® Core™ プロセッサ搭載 USB3.1 (Gen2)×6、COM×3装備

RCX-1540R PEG

- 最大350WハイエンドGPU×2基搭載可能
- 第9世代 インテル® Core™ プロセッサ / インテル® Xeon® E プロセッサを搭載可能
- インテル® C246 チップセット装備
- USB3.1(Gen2)×6基装備
- COMポート×3基装備
- 6V~36V DC-in、80Vサージ保護
- 32 DIO(16 DI、16 DO)装備
- 2.5"リムーバブルディスク×4基搭載可能
- 長期供給と安定稼働に優れたEmbedded構成



最大350WまでのハイエンドGPUを2基搭載可能

NVIDIA® AmpereアーキテクチャのNVIDIA RTXシリーズ / GeForce RTX 30シリーズを最大2基(2スロットタイプ)まで搭載可能。GPUメモリーによる高速処理が求められるマシンビジョン、ディープラーニング、エッジコンピューティング分野などに適しています。

多数のI/Oとストレージにより、制御機能を集約することが可能

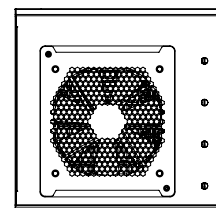
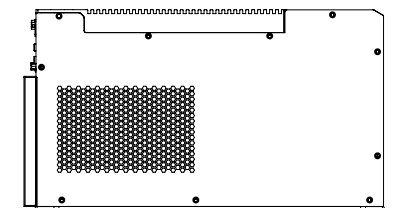
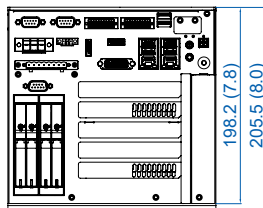
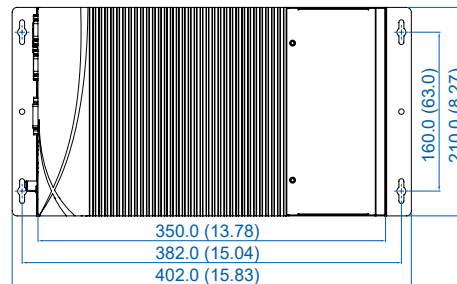
USB3.1 (Gen2)×6基、COMポート×3基、1GbEポート×2基などを装備。リムーバブルドライブによるフロントアクセスが可能で最大4台までのSSD/HDDを搭載することができます。

※画像はイメージです

■製品仕様

製品名	RCX-1540R PEG	
プロセッサ	種類	第9世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー 第8世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー インテル® Xeon® E プロセッサ・ファミリー
	搭載数	1
チップセット	インテル® C246 チップセット	
メモリー	規格	DDR4 2666MHz SO-DIMM
	容量	最大128GB
	スロット数	4
ストレージ	2.5" SSD/HDD	4 (フロントアクセス)
	M.2	1 (Key M ソケット)
SIM カードソケット	2	
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス 630	
I/O	シリアル (COM)	3 (RS-232/422/485)
	USB	6 (USB3.1, Gen2)
	DIO	絶縁型32 (16 DI, 16 DO)
	DisplayPort	1 (最大4096 × 2304 @ 60Hz)
	Digital Display	1 (最大4096 × 2304 @ 60Hz)
	DVI-I	1 (最大1920 × 1200 @ 60Hz)
	Ethernet (1GbE)	LAN 1 : インテル® I219LM GigE LAN, iAMT 12.0 LAN 2 : インテル® I210 GigE LAN
拡張スロット	PCI-Express	PCI-Express x16スロット (Gen 3.0, x8シグナル) ×2 PCI-Express x16スロット (Gen 3.0, x4シグナル) ×2 ※オプションになります。 PCI-Express x4スロット (Gen 3.0, x1シグナル) ×2 ※オプションになります。
	Mini PCI-Express	フルサイズ (PCI-Express/USB/External SIM Card/mSATA用)×2
	M.2	1 (Key E ソケット)
オーディオ	コーデック	Realtek ALC885, 7.1 Channel HD Audio
	端子	1 Mic-in, 1 Line-out
電源	入力電圧	6V~36V、DC-in, 12V PEG Power
	ACアダプター	オプション 160W ACアダプター (PSE認証, 24V, 85V AC~264V AC) ※ACアダプターは3-pin Terminal Blockを使用します。※ACアダプターは-30℃~+70℃対応。 700W ACアダプター、1500W ACアダプター (PSE認証, 12V, 90V AC~264V AC) ※ACアダプターは3-pin Terminal Blockを使用します。
	電源入力タイプ	DC-in: 3-pin Terminal Block: V+, V-, Frame Ground PEG Power: 8-pin Terminal Block: 4V+, 4V-
	イグニッションコントロール	16 Mode (内部)
	リモートスイッチ	3-pin Terminal Block
	サージ保護	過渡電圧:最大80V/1ms
外觀寸法 (W × L × H)	350mm × 210mm × 198.2mm (突起物等を除く)	
重量	約7.1kg ※GPUカードを除く	
取付方法	ウォールマウント用ブラケット	
利用環境	動作温度	-25℃~+45℃ ※動作温度は搭載する拡張ボードに依存します。
	保存温度	-40℃~+85℃
	湿度	5%~95% RH (結露なきこと)
	耐衝撃性/耐振動性	IEC 61373 : 2010、SSD搭載時50G @ ウォールマウント、Half-sine, 11ms 鉄道アプリケーション : 鉄道車両用機器、衝撃・振動試験
	EMC指令	CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2

■I/Oポート/ 寸法 単位:mm(inch)



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL : 03-5446-5535 mail : cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト : <https://embe.hpc.co.jp/>

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

2021年8月現在の内容です。